**Branchenweit erstes Verkabelungssystem mit MDC-Steckverbinder ab sofort verfügbar**

**384 Fasern auf einer Höheneinheit im Patchbereich: Innovatives tML LWL-MDC-Modul von tde punktet mit High-Density**

**Dortmund, 10. November 2020. Als erster Netzwerkhersteller stellt die tde - trans data elektronik GmbH ihre erfolgreichen tML-Standard, tML24- und tML-Xtended-Verkabelungssysteme ab sofort auch mit LWL-MDC-Modulen zur Verfügung: Durch die Integration des kompakten MDC-Steckverbinders von US Conec in die Systemplattform verdoppelt sich die Packungsdichte mit 384 Fasern auf einer Höheneinheit im Patchbereich gegenüber LC-Duplex-Steckverbindern. Das spart wertvollen Platz in Rechenzentren. Im Rückraum bindet das neue Modul die bewährte MPO-Technologie mit Plug-and-play-Funktionalität ein. Kunden können ihre bestehenden tML-Systeme mit LC-Duplex-Modulen problemlos gegen MDC-Module austauschen und aktualisieren. Damit erhalten sie die branchenweit höchste Packungsdichte mit Einzelfasersteckverbindern und profitieren von investitionssicheren High-Density-Anwendungen, zukunftssicheren Highspeed-Netzwerken mit Übertragungen von bis zu 400G und mehr Energieeffizienz im Patchbereich.**

Platz in Rechenzentren ist rar und wertvoll. Um die Raumnutzung weiter zu optimieren und den vorhandenen Platz bestmöglich zu nutzen, hat die tde den von US Conec entwickelten kompakten MDC-Steckverbinder erfolgreich in ihre tML-Systemplattformen integriert: „Als Technologie-Pionier sowie langjähriger und vertrauensvoller Partner von US Conec kombinieren wir den Vorteil des sehr kompakten MDC-Steckverbinders mit unseren tML-Systemen. So können wir bereits heute als erster Hersteller überhaupt eine modulare Verkabelungsplattform basierend auf dem LWL-MDC-Modul anbieten und liefern – damit unterstreichen wir unseren Anspruch als Innovationsführer“, sagt André Engel, Geschäftsführer der tde. Das LWL-MDC-Modul mit dem MDC-Steckverbinder in OM4 ist für die Verkabelungssysteme tML-Standard, tML24- und tML-Xtended verfügbar.

*tML-Packungseffizienz Hoch2 und Vervierfachung der Portdichte*

Mit dem neuen tML LWL-MDC-Modul kann die tde die Packungseffizienz ihres skalierfähigen tML-Systems im Patchbereich nochmals erheblich steigern: Da mit dem kompakten Steckverbinder bis zu 48 Fasern in einem tML-Modul sowie 192 x 2 Fasern mit insgesamt 384 Fasern auf einer 19-Zoll-Höheneinheit Patz finden, verdoppelt sich die Packungsdichte im Vergleich zur Verwendung von LC-Duplex-Steckverbindern. Gegenüber dem Branchenstandard kann die tde sogar eine um Faktor vier höhere Anzahl an Ports anbieten. Im Rückraum setzen die tML-Module auf die bewährte MPO-Technologie, wobei das tML24-System zwei 24-Faser-MPOs einbindet. „Das Ergebnis sind drastische Einsparungen an teurer Fläche und ein Mehr an Green IT, da diese Fläche nicht klimatisiert werden muss“, erläutert André Engel.

*Prädestiniert für Breakout-Anwendungen*
Der auf der 1,25-mm-Vollkeramik-Ferrule basierende MDC-Steckverbinder gehört zur Kategorie der VSFF-Steckverbinder (Very Small Form Factor). US Conec hat ihn für die neue Generation der High-Density-Transceiver SFP-DD, QSFP-DD und OSFP mit Übertragungsraten von 200 bis 400G entwickelt und optimiert. Mit seiner Option für Breakout-Anwendungen können Netzwerktechniker die Übertragungsraten in Kanäle mit niedrigerer Kanal-Geschwindigkeit aufteilen. Dadurch lassen sich die Chassis der aktiven Komponenten mit höheren Portzahlen und Packungsdichten effizienter nutzen.

„In naher Zukunft werden Transceiver-Schnittstellen für den MDC-Steckverbinder auf den Markt kommen. Gleichwohl bleibt die hochfaserige MPO-Verkabelung im Rückraum mit möglichst flexibler Modultechnik die zukunfts- und investitionssichere Lösung – wenn sie *alle* relevanten Steckverbinder integriert“, sagt André Engel. „Deshalb freuen wir uns, dass wir mit der erfolgreichen MDC-Integration unseren Kunden die Wahl lassen können, auf welchen Wegen sie zu Highspeed-Übertragungen bis aktuell 400G migrieren wollen.“

**Weitere Informationen zum neuen tML LWL-MDC-Modul finden Sie auch unter:** <https://www.tde.de/de/produktdetails/tml-24-lwl-modul-2x-24f-mpo-ohne-pins-24x-mdc-50-125u-om4-tml-m24md-02m2-50g4-50545.html>

**Über die tde – trans data elektronik GmbH**
Als international erfolgreiches Unternehmen ist die tde – trans data elektronik GmbH seit mehr als 25 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung skalierbarer Verkabelungssysteme für größte Packungsdichten spezialisiert. Auch das Kernforschungszentrum CERN vertraut auf das Know-how des Technologieführers in der Mehrfasertechnik (MPO). Das Portfolio „Made in Germany“ umfasst komplette Systemlösungen mit Schwerpunkt Plug-and-play für High-Speed-Anwendungen im Bereich Datacom, Telecom, Industry, Medical und Defence. tde bietet mit einer eigenen Service-Abteilung Planungs- und Installationsleistungen aus einer Hand und unterstützt den „European Code of Conduct“ für Energieeffizienz in Rechenzentren. Mehr unter: [www.tde.de](http://www.tde.de/) sowie auf [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/tde-trans-data-elektronik-gmbh/), [Twitter](https://twitter.com/tdeConnect) und [Xing](https://www.xing.com/companies/tde-transdataelektronikgmbh).

**Unternehmenskontakt**tde – trans data elektronik GmbH, Vertriebsbüro Dortmund
André Engel, Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46, D - 44135 Dortmund
Tel. +49 231 160480, Fax +49 231 160933, info@tde.de, [www.tde.de](http://www.tde.de/)

**Pressekontakt**epr – elsaesser public relations, Maximilianstraße 50, D - 86150 Augsburg

Frauke Schütz, Tel: +49 821 4508 7916, fs@epr-online.de

Sabine Hensold, Tel: +49 821 4508 7917,sh@epr-online.de

[www.epr-online.de](http://www.epr-online.de/)